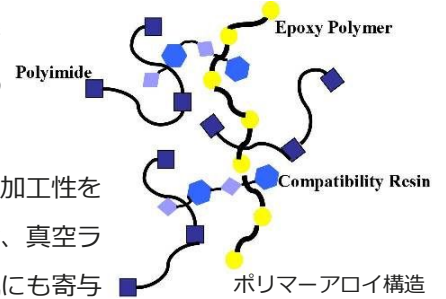


用途：多層 FPC, フレックスリジッド用層間絶縁フィルム、等

1.概要と特徴

1-1)概要 多層 FPC やフレックスリジッド用の層間絶縁フィルムです。主成分はエポキシ樹脂とポリアイミド樹脂で、独自の
変性技術を用いてポリマーアロイ化しております。

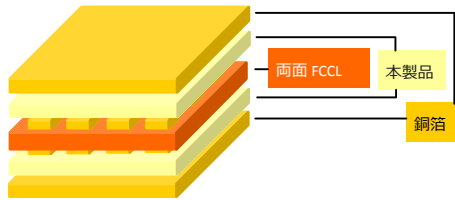


1-2)特徴 ポリアイミドの優れた耐熱性・屈曲性とエポキシの優れた加工性を両立させます。また、多層化には真空プレス成形は勿論、真空ラミネーターにも対応しておりますので、工程費用の削減にも寄与
出来ます。

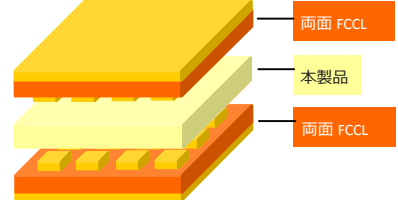
2.用途

2-1)多層 FPC

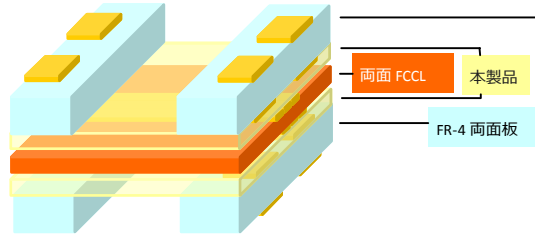
1 コア 4 層 多層 FPC



2 コア 4 層 多層 FPC



2-2)フレックスリジッド



本製品は、FCCL と CCL を接合すると共にカバーレイの役割も果たしますので、薄型化・工程短縮も可能となります。

3.物性

項目	単位	特性値	備考
ガラス転移点	℃	142	TMA
熱膨張係数	ppm/℃	70	α1、TMA
		250	α2、TMA
弾性率	GPa	1.8	JPCA-BU01-2007
破断強度	MPa	87	JPCA-BU01-2007
伸び	%	10.8	JPCA-BU01-2007
ピール強度	kN/m	1.0	18um VLP 銅箔
製品厚み	um	15,20,25,30,40,50	マイクロメーター、成形後

4.使用方法

真空プレス条件

成形条件：130℃×30min / 0.5MPa +190℃×75min / 2MPa

真空ラミネート条件

真空ラミネート条件：110℃×30sec./ vacuum

+ 110℃×30sec./ 0.8~1.0MPa

乾燥炉硬化条件：130℃×30min+190℃×75min

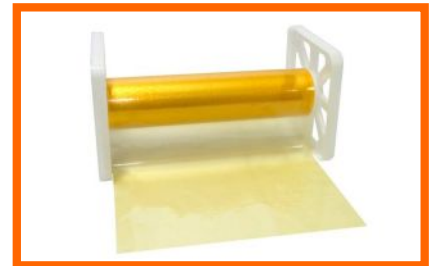
〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12-5

株式会社ピーアイ技術研究所

横浜本社 営業部

TEL：045-778-3355 FAX：045-778-3356

E-mail：info@pird.co.jp



5.お問い合わせ先